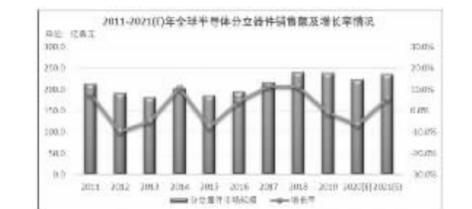


杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A46 版)



资料来源:WSTS,2020.06
受益于国家产业政策对新兴产业的大力支持和对传统行业的升级改造,我国分立器件行业市场规模稳步增长,销售收入占全球比重逐年上升。



数据来源:中国半导体行业协会,2019.08,中国半导体行业协会对“分立器件”的定义范围较广,上图半导体分立器件的数据统计范围涵盖了除集成电路以外的所有部分,包括国际上通常定义的分立器件、光电器件、传感器。

(4)公司在分立器件市场的竞争地位未发生重大不利变化
我国分立器件行业起步较晚,主要通过国外引进和国内企业自主创新,逐步提升行业的国产化程度,满足日益增长的下游需求。

根据中国半导体行业协会的统计,公司在2017年中国分立器件行业十强企业评选中位列第八名。

3.公司主要指标与2019年主要经营业绩变动原因
公司2019年与2018年利润表主要经营业绩对比如下:

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 同比增减. Rows include 营业收入, 营业毛利, 管理费用, etc.

公司2019年度业绩下降的主要原因系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加。

2019年,发行人研发投入增加2018年增加1,038.01万元,研发费用率上升至8.14%,研发费用的增加主要来自子公司立昂芯和衢州金瑞微陆续投产。

2019年,发行人财务费用增加2018年增加2,995.81万元,财务费用率上升至7.55%,财务费用的增加主要是由于发行人增加了短期借款、长期借款。

2019年,发行人资产减值损失和信用减值损失较2018年增加1,882.77万元,增加比例达57.43%。

2019年,发行人研发投入增加2018年增加1,038.01万元,研发费用率上升至8.14%。

2019年,发行人研发投入增加2018年增加2,995.81万元,财务费用率上升至7.55%。

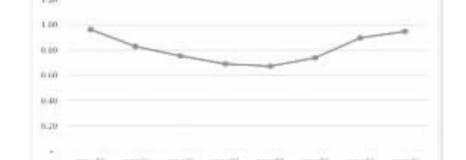
2.发行人的收入规模和综合毛利率水平对持续经营能力的影响分析

(1)收入规模趋势
报告期内,发行人的营业收入分别为93,201.96万元、122,266.70万元和119,168.60万元。

(2)综合毛利率水平
报告期内,发行人的综合毛利率分别为29.98%、37.69%和37.31%。

鉴于发行人已具备一定的生产规模,营业成本相对固定,故发行人产品的销售价格对毛利率的影响更大。

2012年至2019年,全球半导体硅片市场价格波动情况如下图所示:



数据来源:SEMI
由上图可见,2017年起,全球半导体硅片市场明显回暖,产品需求持续上升。

2019年下半年开始,全球半导体硅片市场景气度在阶段性高点后有所回落。

上述半导体硅片行业景气度与半导体硅片市场价格的变化情况与发行人2020年半年度综合毛利率的变化(从2019年的37.31%下降至36.61%)。

综上分析,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019年业绩下滑主要因素对持续经营能力的影响
2019年公司经营业绩大幅下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括8英寸及12英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片及MOSFET芯片等多类产品正处于生产线建设及产能爬坡阶段。

2019年下半年开始,全球半导体硅片市场景气度在阶段性高点后有所回落。

上述半导体硅片行业景气度与半导体硅片市场价格的变化情况与发行人2020年半年度综合毛利率的变化(从2019年的37.31%下降至36.61%)。

综上分析,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

14.财务报告审计截止日后的主要经营业绩
公司财务报告截止日至2020年3月31日,根据《关于首次公开发行股票并上市申报审计截止日后的主要经营业绩公告》。

根据我们的审阅,我们并没有注意到任何事项使我们相信立昂微电子2020年2季度财务报告没有按照企业会计准则的规定编制。

公司在招股意向书中“十一”之“九、财务报告审计截止日后的主要经营业绩”中披露了审计截止日至2020年3月31日后的主要经营业绩。

注:2019年4-6月数据未经审计,下同。

Table with 4 columns: 项目, 2020年4-6月, 2019年4-6月, 变动比例. Rows include 营业收入, 营业毛利, etc.

注:2019年4-6月数据未经审计,下同。

Table with 4 columns: 项目, 2020年4-6月, 2019年4-6月, 变动比例. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, etc.

(二)审计截止日后主要经营业绩
财务报告审计截止日至本招股意向书签署日,公司经营情况稳定,相关产业政策未发生重大调整。

结合半年度经营业绩、在手订单情况以及对下游客户的销售预期,公司预计2020年1-9月将实现营业收入93,096.26万元至107,218.36万元。

截至本招股意向书签署日,发行人前十名自然人股东持股数量及比例情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例. Rows include 王文文, 宁波波科, etc.

4.国有股份或外资股份
截至本招股意向书签署日,发行人不存在国有股份或外资股份。

截至本招股意向书签署日,发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例. Rows include 王文文, 宁波波科, etc.

一、发行人基本情况
中文名称:杭州立昂微电子股份有限公司
英文名称:Hangzhou Lion Electronics Co.,Ltd

二、发行人主营业务
发行人主营业务为半导体硅片和分立器件的研发、生产和销售。

股份公司成立日期:2011年11月16日
住所:杭州经济技术开发区20号大街199号

统一社会信用代码:91330100736871634P
电话:0571-86597207
传真:0571-86729010

互联网网址:www.li-on.com
电子邮箱:li@li-on.com

发行人系由立昂有限的全体股东为发起人,以经中汇会计师事务所有限公司中汇会审[2011]2421号《审计报告》审计的公司截至2011年9月30日的净资产123,020,479.54元为基础。

2011年10月31日,中汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中汇会验[2011]2489号),确认截至2011年10月31日,全体股东已缴纳新增注册资本合计7,000万元。

2011年11月16日,立昂微电领取了杭州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号为330198000040201)。

(二)发起人及其投入的资产内容
公司设立时,各发起人及其持股情况如下表:

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例. Rows include 王文文, 宁波波科, etc.

本公司系由立昂有限整体变更设立,上述发起人均以立昂有限的净资产出资。

三、发行人有关股本情况
(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本为36,000万股,本次公开发行新股不超过4,058万股,占发行前总股本的比例不低于10.00%,不超过10.1313%。

(二)持股数量及比例情况
(1)自然人发起人
33名自然人发起人共同发起设立股份公司时,共有47名自然人发起人。

序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例
1 王文文 7,961.57 22.12%

发行人的子公司浙江金瑞微、衢州金瑞微主要从事半导体硅片业务(不包括12英寸半导体硅片)。

此外,发行人的子公司金瑞微微电子主要从事12英寸半导体硅片业务,立昂微电子主要从事微波射频集成电路芯片业务。

(二)发行人的主要产品及其用途
1.半导体硅片产品
公司半导体硅片产品主要是硅抛光片、硅外延片,具体情况如下:



2.半导体器件芯片产品
公司半导体分立器件芯片产品主要是肖特基二极管芯片和MOSFET芯片,具体情况如下:



3.半导体分立器件成品
公司半导体分立器件成品主要为肖特基二极管,具体情况如下:



(三)产品销售方式和渠道
公司产品的主要销售渠道包括直销和经销。

(四)所需主要材料及能源
发行人生产所需的主要材料包括硅片、半导体分立器件芯片和半导体分立器件成品。

(五)行业竞争情况
1.全球市场情况
从全球市场来看,半导体硅片市场具有较高的垄断性。

2.国内市场情况
从国内市场来看,由于我国从20世纪90年代逐步开始加大对半导体产业的投入。

根据IC Mria统计,目前国内从事新材料业务的公司主要包括浙江金瑞微、有研半导体、中环股份、南京国盛、上海新昇、上海新傲、昆山中辰等十余家。

2017年全球主要半导体硅片供应商市场份额图

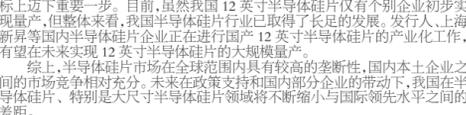


数据来源:Gartner, 2019.06

(二)国内市场情况
从国内市场来看,由于我国从20世纪90年代逐步开始加大对半导体产业的投入。

根据IC Mria统计,目前国内从事新材料业务的公司主要包括浙江金瑞微、有研半导体、中环股份、南京国盛、上海新昇、上海新傲、昆山中辰等十余家。

2017年全球主要半导体硅片供应商市场份额图



数据来源:Gartner, 2019.06

(二)国内市场情况
从国内市场来看,由于我国从20世纪90年代逐步开始加大对半导体产业的投入。

根据IC Mria统计,目前国内从事新材料业务的公司主要包括浙江金瑞微、有研半导体、中环股份、南京国盛、上海新昇、上海新傲、昆山中辰等十余家。

2017年全球主要半导体硅片供应商市场份额图



数据来源:Gartner, 2019.06

(二)国内市场情况
从国内市场来看,由于我国从20世纪90年代逐步开始加大对半导体产业的投入。

根据IC Mria统计,目前国内从事新材料业务的公司主要包括浙江金瑞微、有研半导体、中环股份、南京国盛、上海新昇、上海新傲、昆山中辰等十余家。

2017年全球主要半导体硅片供应商市场份额图

